



连接器 > 射频连接器 > 同轴连接器



射频接口：OSP/BMA

射频连接器种类：**插头**

射频连接器插接外直径（近似值）：7.62 mm [.3 in]

阻抗：50 Ω

射频连接器耦合机制：**推入式**

产品特性

产品类型特性

射频接口	OSP/BMA
射频连接器种类	插头
连接器系统	线到面板
可密封	是

结构特性

位数	1
同轴端子数	1

电气特征

阻抗	50 Ω
----	------

主体特性

主体材料	不锈钢
主体材料表面涂层	钝化

接触件特性

射频连接器中心端子底板材料	铜
射频连接器中心端子电镀材料	金 (Au)
射频连接器中心端子材料	铍铜合金

机械附件

面板安装特性类型	法兰
面板安装方式	前端安装



射频连接器耦合机制	推入式
连接器安装类型	面板安装
制动器	不带

壳体特性

主体方向	直式
------	----

尺寸

射频连接器插接外直径（近似值）	7.62 mm[.3 in]
-----------------	----------------

操作/应用

工作频率范围	22 GHz
--------	--------

包装特性

封装方法	包装
------	----

其他

电介质材料	TFE 碳氟化合物
-------	-----------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	Compliant with Exemptions
欧盟ELV指令2000/53/EC	Compliant with Exemptions
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	有害物质含量超出标准 Restricted Substance(s) Above Threshold
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	Current ECHA Candidate List: JUNE 2025 (250) Candidate List Declared Against: JAN 2020 (205) SVHC > Threshold: Not Yet Reviewed
卤素含量	Low Bromine/Chlorine - Br and Cl < 900 ppm per homogenous material. Also BFR /CFR/PVC Free
焊接工艺能力	Pin-in-Paste capable to 260°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免



免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

该系列中的其他产品 | OSP/BMA 小型模块化



客户还购买了



文档

产品图纸
4551 3357 02
英文版本

CAD 文件
3D PDF
3D
下载查看
[ENG_CVM_CVM_1059572-1_B.2d_dxf.zip](#)
英文版本
下载查看



[ENG_CVM_CVM_1059572-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1059572-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

Blind Mate Connectors

英文版本

rf-connectors-product-refresh-phase-2

英文版本